

# インタビュー

FICT(株)  
代表取締役社長

## 雨宮 隆久氏



ただ、一部の部材の調達難が生じており、生産に支障をきたさないよう現場への指示出しを常に行っている。

超高度層基板や大型半導体パッケージ基板の製造を得意とするFICT(株)(長野市)の足元における業績が好調だ。AIサーバー向けや半導体テスター関連の旺盛な需要が牽引する。次世代の高性能・高集積デバイスも普及を見据え、高密度で製造難易度の高いインターコネクタ技術の確立も急ぐ。現況と2026年度以降の事業展望などを雨宮隆久社長に聞いた。

超高度層基板や大型半導体パッケージ基板の製造を得意とするFICT(株)(長野市)の足元における業績が好調だ。AIサーバー向けや半導体テスター関連の旺盛な需要が牽引する。次世代の高性能・高集積デバイスも普及を見据え、高密度で製造難易度の高いインターコネクタ技術の確立も急ぐ。現況と2026年度以降の事業展望などを雨宮隆久社長に聞いた。

# 超高度層板受注が急拡大

## 長野で研究開発機能を強化

主流だ。さらに半導体用プローブカードならびに、半導体検査関連装置向けのメイン基板をはじめ、SAP技術を用いたST(スペース・トランスフォーマー)なども高水準の受注を維持する。

26年度の事業見通しをお聞かせ下さい。

雨宮 25年度はおかげさまで前年度比20%前後の増収増益を確保できた。26年度も旺盛なAI需要が牽引、引き続き高成長を期待する。超高度層板や高密度化ニーズを的確に捉え、顧客需要に積極的に応えていく。

雨宮 好調に推移している。AI需要が牽引して、半導体テスターや高性能サーバーの超高度層基板向けの受注が大きく伸びている。高性能サーバー向けにコア基板の高精

度なビア形成・ルーター加工なども手がけている。拠点の黒姫工場稼働率が引き上がってきており、30〜40層板が

株主構成も変わりましたね。

雨宮 25年2月、PEファンドのMBKパートナー

新たに開設したのは川崎フボラトリーと福岡県

高集積デバイスの登場で、3D実装などのハイエンドパッケージ開発が加速している。また、高密度化の流れが出ているSTやパッケージ基板の大型化、RDL(再配線層)形成などファインピッチに対応したインターコネクタ技術を磨いている。

り、ガラス基板も含めた高度な3D実装の開発拠点を位置づけている。

雨宮 昨今、高速メモリなどの普及も進み、これらに対応した超高度層のプローブカードが必須になっている。100層近い超高度層基板も登場している。

さらなる超高度層化の要求が出てくるだろう。すでに25年秋には板厚10mm、160層の超高度層基板の開発も完了した。

独自のFALCS工法を活用、複数の多層板ブロックをあらかじめ形成しておき、最後に各ブロックの層間ビア同士を導電性ペーストで接続している。FALCSはL/S50μm/50μmまでの微細化が可能で、ビアのスタブ(Stub)が形成されないので高速信

号処理の基板には最適だ。26年内には180層に挑戦する。

投資の考え方は。

雨宮 長野本社工場では微細な配線に対応するためのSAP工程のボルトネック改善などに注力している。AMR(自律移動型搬送ロボット)など自動化を最大限導入し、またクリーンルームもクラス100といった超清浄空間で、パーティクル対策なども半導体工場並みに講じている。高精度なビア形成を請け負う黒姫工場では、高効率な多軸機能を備えたメカニカルドリルへの切り替えを進め、生産性の向上を図っている。

なお、長野本社工場では開発ラインの拡張工事を進めており、次世代の開発機能の強化も進めている。27年度の開設を目指しており、スタッフも増員する。

(聞き手・特別編集委員 野村和広)

雨宮 新規に研究開発拠点を開設しました。狙いは。

雨宮 次世代の高速・

